

# 2016-2022年中国集成电路封装行业运营现状与盈利战略分析报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2016-2022年中国集成电路封装行业运营现状与盈利战略分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/236926236926.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

中国报告网发布的《2016-2022年中国集成电路封装行业运营现状与盈利战略分析报告》首先介绍了集成电路封装行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。

### 第一章：国内集成电路封装行业进展背景 19

#### 1.1 集成电路封装行业定义及种类 19

##### 1.1.1 集成电路封装行业定义 19

##### 1.1.2 集成电路封装行业产品大类 19

##### 1.1.3 集成电路封装行业特性预测 20

###### (1) 行业周期性 20

###### (2) 行业地区性 20

###### (3) 行业季节性 21

##### 1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位预测 21

#### 1.2 集成电路封装行业政策环境条件预测 22

##### 1.2.1 行业管理体制 22

##### 1.2.2 行业相关政策 23

#### 1.3 集成电路封装行业经济环境条件预测 23

##### 1.3.1 国际宏观经济环境条件及影响预测 23

###### (1) 国际宏观经济现状 23

###### (2) 国际宏观经济环境条件对行业影响预测 25

##### 1.3.2 中国宏观经济环境条件及影响预测 26

###### (1) GDP增长情况预测 26

###### (2) 居民收入水平 27

#### 1.4 集成电路封装行业技能环境条件预测 28

##### 1.4.1 集成电路封装技能演进预测 28

##### 1.4.2 集成电路封装形式应用领域 29

##### 1.4.3 集成电路封装工艺流程预测 29

##### 1.4.4 集成电路封装行业新技能走势 30

### 第二章：国内集成电路产业进展预测 32

#### 2.1 集成电路产业进展趋势 32

##### 2.1.1 集成电路产业链简介 32

##### 2.1.2 集成电路产业进展现状透析 32

- (1) 行业进展势头良好 32
- (2) 行业技能水平快速提升 33
- (3) 行业竞争力仍有待加强 33
- (4) 产业结构进一步优化 33
- 2.1.3 集成电路产业地区进展格局预测 34
  - (1) 三大地区集聚进展格局业已形成 34
  - (2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征 35
  - (3) 产业整体将“有聚有分，东进西移” 36
- 2.1.4 集成电路产业面临的进展机遇 37
  - (1) 产业政策环境条件进一步向好 37
  - (2) 策略性新兴产业将加速进展 38
  - (3) 资本市场将为公司融资提供更多机会 38
- 2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 38
  - (1) 范围小 38
  - (2) 创新不足 38
  - (3) 价值链整合不够 39
  - (4) 产业链不完善 39
- 2.1.6 集成电路产业“十三五”进展分析 39
- 2.2 集成电路设计业进展趋势 39
  - 2.2.1 集成电路设计业进展概况 39
  - 2.2.2 集成电路设计业进展特征 40
    - (1) 产业范围持续扩大 40
    - (2) 质量上升数量下降 41
    - (3) 公司范围持续扩大 41
    - (4) 技能能力大幅提升 41
  - 2.2.3 集成电路设计业进展隐忧 42
  - 2.2.4 集成电路设计业新进展战略 42
  - 2.2.5 集成电路设计业“十三五”进展分析 42
- 2.3 集成电路制造业进展趋势 43
  - 2.3.1 集成电路制造业进展现状透析 43
    - (1) 集成电路制造业进展总体概况 43
    - (2) 集成电路制造业进展主要特征 43
    - (3) 集成电路制造业范围及财务指标预测 44
      - 1) 集成电路制造业范围预测 44
      - 2) 集成电路制造业盈利能力预测 44

- 3) 集成电路制造业营销能力预测 45
- 4) 集成电路制造业偿债能力预测 45
- 5) 集成电路制造业进展能力预测 46
- 2.3.2 集成电路制造业经济指标预测 46
  - (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素 46
  - (2) 集成电路制造业经济指标预测 47
  - (3) 不同范围公司主要经济指标比重变化情况预测 48
  - (4) 不同性质公司主要经济指标比重变化情况预测 50
  - (5) 不同区域公司经济指标预测 52
- 2.3.3 集成电路制造业供需平衡预测 65
  - (1) 全国集成电路制造业供给情况预测 65
    - 1) 全国集成电路制造业总产值预测 65
    - 2) 全国集成电路制造业产成品预测 66
  - (2) 全国集成电路制造业需求情况预测 66
    - 1) 全国集成电路制造业销售产值预测 66
    - 2) 全国集成电路制造业销售收入预测 67
  - (3) 全国集成电路制造业产销率预测 68
- 2.3.4 集成电路制造业“十三五”进展分析 68
- 第三章：国内集成电路封装行业进展预测 70
- 3.1 国内集成电路封装行业整体进展情况 70
  - 3.1.1 集成电路封装行业范围预测 70
  - 3.1.2 集成电路封装行业进展现状透析 70
  - 3.1.3 集成电路封装行业利润水平预测 71
  - 3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技能比较 72
  - 3.1.5 集成电路封装行业影响因素预测 72
    - (1) 有利因素 73
    - (2) 不利因素 73
  - 3.1.6 集成电路封装行业进展状况及未来分析 74
    - (1) 进展状况预测 74
    - (2) 未来分析 76
- 3.2 半导体封测技能预测 76
  - 3.2.1 国内半导体行业进展概况 76
  - 3.2.2 半导体行业景气分析 77
  - 3.2.3 半导体封装技能预测 79
    - (1) 封装环节产值逐年成长 79

- (2) 封装环节外包是前景进展状况 79
- 3.3 集成电路封装类专利预测 80
  - 3.3.1 专利预测样本构成 80
    - (1) 数据库选择 80
    - (2) 检索方式 81
  - 3.3.2 封装类专利预测 81
    - (1) 专利公开年度状况 81
    - (2) 中国外专利公开状况对比 81
    - (3) 中国专利公开主要省市分布 82
    - (4) IPC技能种类状况分布 83
    - (5) 主要权利人分布情况 84
- 3.4 集成电路封装过程部分技能问题探讨 84
  - 3.4.1 集成电路封装开裂产生理由 预测及对策 84
    - (1) 封装开裂的影响因素预测 84
    - (2) 管控影响开裂的因素的方法预测 86
  - 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生理由 预测及对策 87
    - (1) 产生芯片弹坑问题的因素预测 87
    - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法 87
- 第四章：国内集成电路封装行业市场需求预测 90
  - 4.1 集成电路市场预测 90
    - 4.1.1 集成电路市场范围 90
    - 4.1.2 集成电路市场结构预测 90
      - (1) 集成电路市场产品结构预测 90
      - (2) 集成电路市场应用结构预测 91
    - 4.1.3 集成电路市场竞争格局 92
    - 4.1.4 集成电路中国市场自给率 92
    - 4.1.5 集成电路市场进展分析 93
  - 4.2 集成电路封装行业需求预测 93
    - 4.2.1 计算机领域对行业的需求预测 93
      - (1) 计算机市场进展现状 93
      - (2) 集成电路在计算机领域的应用 94
      - (3) 计算机领域对行业需求的拉动 94
    - 4.2.2 消费电子领域对行业的需求预测 95
      - (1) 消费电子市场进展现状 95
      - (2) 集成电路在消费电子领域的应用 96

- (3) 消费电子领域对行业需求的拉动 96
- 4.2.3 通信设备领域对行业的需求预测 96
  - (1) 通信设备市场进展现状 96
  - (2) 集成电路在通信设备领域的应用 97
  - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动 97
- 4.2.4 工控设备领域对行业的需求预测 98
  - (1) 工控设备市场进展现状 98
  - (2) 集成电路在工控设备领域的应用 99
  - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动 99
- 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求预测 99
  - (1) 汽车电子市场进展现状 99
  - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用 100
  - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动 100
- 4.2.6 其他应用领域对行业的需求预测 100
- 第五章：集成电路封装行业市场竞争预测 102
- 5.1 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型预测 102
  - 5.1.1 现有竞争者之间的竞争 102
  - 5.1.2 上游议价能力预测 103
  - 5.1.3 下游议价能力预测 103
  - 5.1.4 行业潜在进入者预测 104
  - 5.1.5 替代品风险剖析 104
- 5.2 集成电路封装行业国际竞争格局预测 105
  - 5.2.1 国际集成电路封装市场总体进展趋势 105
  - 5.2.2 国际集成电路封装市场竞争趋势预测 106
  - 5.2.3 国际集成电路封装市场进展状况预测 107
    - (1) 封装技能的高密度、高速和高频率以及低成本 107
    - (2) 主板材料的变化状况 109
  - 5.2.4 跨国公司在华市场竞争力预测 110
    - (1) 台湾日月光集团竞争力预测 110
      - 1) 公司进展简介 110
      - 2) 公司经营情况预测 110
      - 3) 公司主营产品及应用领域 111
      - 4) 公司市场地区及行业地位预测 111
      - 5) 公司在国内市场投资布局情况 111
    - (2) 美国安靠 (Amkor) 企业竞争力预测 112

- 1) 公司进展简介 112
- 2) 公司经营情况预测 112
- 3) 公司主营产品及应用领域 112
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 112
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 112
  - (3) 台湾矽品企业竞争力预测 112
- 1) 公司进展简介 113
- 2) 公司经营情况预测 113
- 3) 公司主营产品及应用领域 114
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 114
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 114
  - (4) 新加坡STATS-ChipPAC企业竞争力预测 114
- 1) 公司进展简介 114
- 2) 公司经营情况预测 114
- 3) 公司主营产品及应用领域 115
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 115
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 115
  - (5) 力成科技股份有限公司竞争力预测 115
- 1) 公司进展简介 115
- 2) 公司经营情况预测 115
- 3) 公司主营产品及应用领域 115
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 116
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 116
  - (6) 飞思卡尔企业竞争力预测 116
- 1) 公司进展简介 116
- 2) 公司经营情况预测 116
- 3) 公司主营产品及应用领域 116
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 117
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 117
  - (7) 英飞凌科技企业竞争力预测 117
- 1) 公司进展简介 117
- 2) 公司经营情况预测 117
- 3) 公司主营产品及应用领域 117
- 4) 公司市场地区及行业地位预测 117
- 5) 公司在国内市场投资布局情况 118

5.3 集成电路封装行业中国竞争格局预测	119
5.3.1 中国集成电路封装行业竞争格局预测	119
5.3.2 中国集成电路封装行业集中度预测	120
(1) 行业销售收入集中度预测	120
(2) 行业利润集中度预测	121
(3) 行业工业总产值集中度预测	121
5.3.3 国内集成电路封装行业国际竞争力预测	122
第六章：国内集成电路封装行业产品市场预测	123
6.1 集成电路封装行业BGA产品市场预测	123
6.1.1 BGA封装技能	123
6.1.2 BGA产品主要应用领域	125
6.1.3 BGA产品需求拉动因素	125
6.1.4 BGA产品市场应用现状透析	126
6.1.5 BGA产品市场未来预测	126
6.2 集成电路封装行业SIP产品市场预测	127
6.2.1 SIP封装技能	127
6.2.2 SIP产品主要应用领域	128
6.2.3 SIP产品需求拉动因素	128
6.2.4 SIP产品市场应用现状透析	129
6.2.5 SIP产品市场未来预测	129
6.3 集成电路封装行业SOP产品市场预测	130
6.3.1 SOP封装技能	130
6.3.2 SOP产品主要应用领域	131
6.3.3 SOP产品市场进展现状	132
6.3.4 SOP产品市场未来预测	132
6.4 集成电路封装行业QFP产品市场预测	132
6.4.1 QFP封装技能	132
6.4.2 QFP产品主要应用领域	133
6.4.3 QFP产品市场进展现状	133
6.4.4 QFP产品市场未来预测	133
6.5 集成电路封装行业QFN产品市场预测	134
6.5.1 QFN封装技能	134
6.5.2 QFN产品主要应用领域	134
6.5.3 QFN产品市场进展现状	135
6.5.4 QFN产品市场未来预测	135

## 6.6 集成电路封装行业MCM产品市场预测 135

### 6.6.1 MCM封装技能水平概况 135

(1) 概念简介 135

(2) MCM封装种类 136

### 6.6.2 MCM产品主要应用领域 136

### 6.6.3 MCM产品需求拉动因素 136

### 6.6.4 MCM产品市场进展现状 137

### 6.6.5 MCM产品市场未来预测 138

## 6.7 集成电路封装行业CSP产品市场预测 139

### 6.7.1 CSP封装技能水平概况 139

(1) 概念简介 139

(2) CSP产品特征 139

(3) CSP封装种类 140

### 6.7.2 CSP产品主要应用领域 141

### 6.7.3 CSP产品市场进展现状 141

### 6.7.4 CSP产品市场未来预测 142

## 6.8 集成电路封装行业其他产品市场预测 142

### 6.8.1 晶圆级封装市场预测 142

(1) 概念简介 142

(2) 产品特征 143

(3) 主要应用领域 143

(4) 市场范围与主要供应商 144

(5) 未来预测 144

### 6.8.2 覆晶/倒封装市场预测 145

(1) 概念简介 145

(2) 产品特征 145

(3) 市场未来 145

### 6.8.3 3D封装市场预测 145

(1) 概念简介 145

(2) 封装方法 146

(3) 封装特征 146

(4) 进展现状与未来 147

## 第七章：国内集成电路封装行业主要公司经营预测 148

### 7.1 集成电路封装公司进展总体趋势预测 148

#### 7.1.1 集成电路封装行业制造商工业总产值排名 148

- 7.1.2 集成电路封装行业制造商销售收入排名 148
- 7.1.3 集成电路封装行业制造商利润总额排名 149
- 7.2 集成电路封装行业领先公司个案预测 150
  - 7.2.1 飞思卡尔半导体（国内）有限企业经营情况预测 150
    - (1) 公司进展简况预测 150
    - (2) 公司产销能力预测 150
    - (3) 公司盈利能力预测 151
    - (4) 公司营销能力预测 151
    - (5) 公司偿债能力预测 152
    - (6) 公司进展能力预测 152
    - (7) 公司产品结构及新产品动向 153
    - (8) 公司销售渠道与网络 153
    - (9) 公司经营趋势优劣势预测 153
  - 7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限企业经营情况预测 153
    - (1) 公司进展简况预测 153
    - (2) 公司产销能力预测 154
    - (3) 公司盈利能力预测 154
    - (4) 公司营销能力预测 155
    - (5) 公司偿债能力预测 155
    - (6) 公司进展能力预测 156
    - (7) 公司产品结构及新产品动向 156
    - (8) 公司销售渠道与网络 156
    - (9) 公司经营趋势优劣势预测 156
  - 7.2.3 江苏长电科技股份有限公司企业经营情况预测 157
    - (1) 公司进展简况预测 157
    - (2) 主要经济指标预测 158
    - (3) 公司盈利能力预测 159
    - (4) 公司营销能力预测 160
    - (5) 公司偿债能力预测 160
    - (6) 公司进展能力预测 161
    - (7) 公司组织架构预测 161
    - (8) 公司产品结构及新产品动向 162
    - (9) 公司销售渠道与网络 163
    - (10) 公司经营趋势优劣势预测 163
    - (11) 公司投资兼并与重组预测 163

(12) 公司最新进展动向预测	164
7.2.4 上海松下半导体有限企业经营情况预测	164
(1) 公司进展简况预测	164
(2) 公司产销能力预测	164
(3) 公司盈利能力预测	165
(4) 公司营销能力预测	165
(5) 公司偿债能力预测	166
(6) 公司进展能力预测	166
(7) 公司产品结构及新产品动向	167
(8) 公司销售渠道与网络	167
(9) 公司经营趋势优劣势预测	167
7.2.5 深圳赛意法微电子有限企业经营情况预测	167
(1) 公司进展简况预测	168
(2) 公司产销能力预测	168
(3) 公司盈利能力预测	168
(4) 公司营销能力预测	169
(5) 公司偿债能力预测	169
(6) 公司进展能力预测	170
(7) 公司产品结构及新产品动向	170
(8) 公司销售渠道与网络	171
(9) 公司经营趋势优劣势预测	171
(10) 公司最新进展动向预测	171
第八章：国内集成电路封装行业投资预测及意见	266
8.1 集成电路封装行业投资特性预测	266
8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒	266
(1) 技能壁垒	266
(2) 资金壁垒	266
(3) 人才壁垒	266
(4) 严格的客户认证制度	266
8.1.2 集成电路封装行业盈利模式	267
8.1.3 集成电路封装行业盈利因素	267
8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组预测	268
8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况	268
8.2.2 国际集成电路封装公司投资兼并与重组整合预测	268
8.2.3 中国集成电路封装公司投资兼并与重组整合预测	270

- (1) 通富微电企业投资兼并与重组预测 270
- (2) 华天科技企业投资兼并与重组预测 272
- (3) 长电科技企业投资兼并与重组预测 272
- 8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合状况预测 274
- 8.3 集成电路封装行业投融资预测 274
- 8.3.1 电子进展基金对集成电路产业的扶持预测 274
  - (1) 电子进展基金对集成电路产业的扶持情况 274
  - (2) 电子进展基金对集成电路产业的扶持意见 275
- 8.3.2 集成电路封装行业融资成本预测 276
- 8.3.3 半导体行业资本支出预测 276
- 8.4 集成电路封装行业投资意见 277
- 8.4.1 集成电路封装行业投资机会预测 277
- 8.4.2 集成电路封装行业投资风险剖析 278
- 8.4.3 集成电路封装行业投资意见 281
  - (1) 投资地区意见 281
  - (2) 投资产品意见 281
  - (3) 技能升级意见 282
- 图表目录
- 图表1：集成电路封装行业产品种类 19
- 图表2：我国集成电路封装公司区域分布（单位：%） 20
- 图表3：2015年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元） 21
- 图表4：2009-2015年集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%） 22
- 图表5：集成电路封装行业主要政策预测 23
- 图表6：2008-2015年4季度世界主要经济体经济增长速度（单位：%） 24
- 图表7：2005-2015年4季度各项世界PMI指数变动情况 24
- 图表8：2010-2015年世界主要经济体经济增速及分析预测（单位：%） 25
- 图表9：2005-2015年12月国内GDP增长状况图（单位：%） 26
- 图表10：2008-2015年12月国内GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%） 26
- 图表11：2005-2015年国内城镇居民和农村居民人均可支配收入情况（单位：元） 27
- 图表12：封装技能的演进 28
- 图表13：各种集成电路封装形式应用领域 29

特别说明：中国报告网所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场行情。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/236926236926.html>